

专利名称	专利号	授权日期	发明人	转让方式	受让方	转让金额（元）	转让收益（元）	现金奖励（元）	奖励人	所在单位	技术合同登记号
一种可实现 CSP 器件高强度互连的 Sn 基钎料	ZL202111004674.5	/	张亮、李木兰、郭永环、何 鹏、李志豪	专利权转让	厦门市及时雨焊料有限公司	25000	23000	22080	郭永环	机电工程学院	2024320307000043
一种可实现芯片垂直堆叠的 Sn 基钎料及其键合方法	ZL202111015355.4	/	张亮、李志豪、郭永环、何 鹏、李木兰	专利权转让	厦门市及时雨焊料有限公司	25000	23000	22080	郭永环	机电工程学院	2024320307000043